

2021年3月期 第2四半期 決算説明資料



2020年11月6日

2020年12月1日 P3,P6変更



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

当社グループの報告セグメント

電子機器用部材事業 (電材事業)

PWB用部材を始めとする電子部品用
化学品部材の製造販売及び仕入販売



医療・医薬品事業 (医薬事業)

医療用医薬品・医療用医薬部外品
その他に関する開発・製造販売



その他事業

染料・顔料等の化学品の製造販売、
自然エネルギーによる発電事業及び
ソフトウェア開発等



2021年3月期 第2四半期 トピックス

電材事業

売上高は前年同期比で4%増加（EBITDAは前年同期比22%増）
（主要因）半導体市場の成長により、PKG用DFの売上が増加

電材事業

シリコンバレーにCVCを設立
当社にとって有益な技術・事業をもつスタートアップ企業へ投資

医薬事業

売上高は前年同期比で144%増加（EBITDAは前年同期比367%増）
（主要因）2019年10月承継の太陽ファルマテック、2020年4月にアストラゼネカより譲受した4製品の長期収載品の売上寄与による

医薬事業

- ・サイフューズとの細胞製品製造新領域の製造に関するパートナーシップ契約締結
- ・遺伝子治療研究所と製造に関する契約締結

※ 2020年12月1日変更
医薬事業に配分すべき償却費が全社費用に計上されていたため、EBITDAを修正しました。

連結業績

連結業績サマリ

単位：百万円

	① 2020年3月期 上半期 実績	② 2021年3月期 上半期 実績	②-① 前年同期比	(②-①) ÷ ① 増減率	③ 2021年3月期 期初発表※1 上半期 業績予想	②÷③ 進捗率	④ 2021年3月期 今回発表※2 通期 業績予想	⑤ 2021年3月期 期初発表※1 通期 業績予想	(④-⑤) ÷ ⑤ 増減率
売上高	31,202	39,436	+8,234	+26%	40,300	98%	79,700	80,600	-1%
営業利益	4,073	7,011	+2,938	+72%	5,100	137%	12,000	10,100	19%
経常利益	3,928	6,982	+3,054	+78%	5,000	140%	11,600	9,700	20%
親会社株主に帰属 する当期純利益	3,137	4,803	+1,666	+53%	3,300	146%	7,500	6,400	17%
円・USDレート	108.9	106.6	-2.3		105.0		105.0	105.0	
EBITDA	5,965	10,704			8,600		19,200	17,300	
営業利益率	13%	18%			13%		15%	13%	
EBITDA マージン	19%	27%			21%		24%	21%	

※1 2020年5月18日開示

※2 2020年11月6日開示

2021年3月期 連結通期業績予想

セグメント別連結通期業績予想

単位：百万円

円・USD想定レート 105円

	配賦方法変更後 2021年3月期業績予想 今回発表			配賦方法変更後 2021年3月期業績予想 期初発表			(参考) 2021年3月期業績予想 期初発表 配賦方法変更前		
	連結	電材事業	医薬事業	連結	電材事業	医薬事業	連結	電材事業	医薬事業
売上高	79,700	50,400	25,600	80,600	50,000	26,500	80,600	50,000	26,500
営業利益	12,000	9,500	3,600	10,100	7,500 [※]	3,600	10,100	9,100 [※]	3,600
EBITDA	19,200	11,100	8,300	17,300	9,100 [※]	8,300	17,300	10,700 [※]	8,300
営業利益率	15%	19%	14%	13%	15%	14%	13%	18%	14%
EBITDA マージン	24%	22%	32%	21%	18%	31%	21%	21%	31%

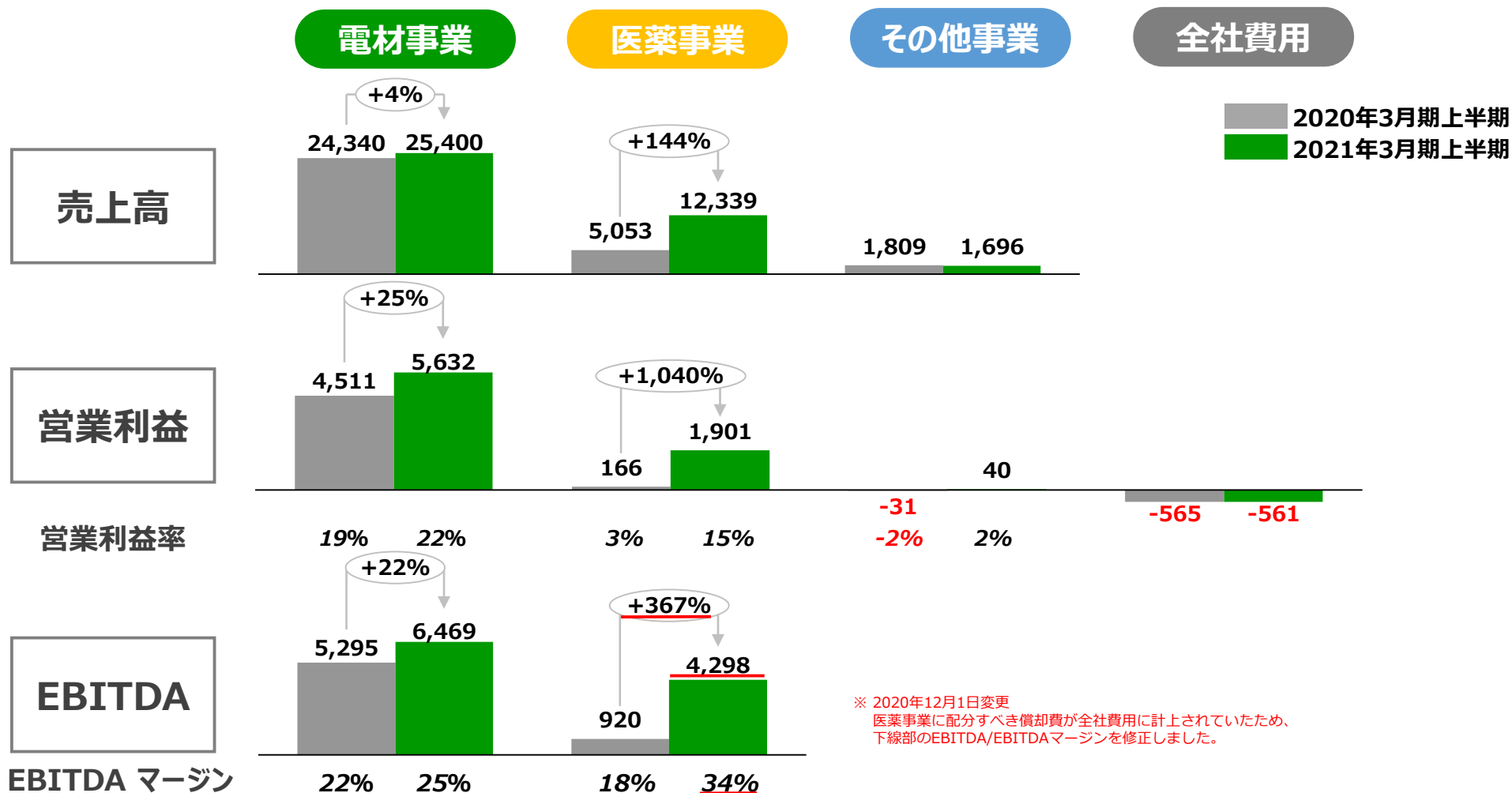
※当第1四半期より、従来は全社費用に含めていた一部費用（研究開発費など）を各報告セグメントに配分しています。

これにより、期初発表の業績予想のセグメント利益は、変更後の報告セグメントの利益の算定方法に基づき再度作成したため、5月18日発表の業績予想と差異が発生しております。

セグメント別業績

上半期セグメント別売上高・営業利益・EBITDA

単位：百万円



※ 2020年12月1日変更
医薬事業に配分すべき償却費が全社費用に計上されていたため、
下線部のEBITDA/EBITDAマージンを修正しました。

※前第3四半期より、従来は全社費用として差異調整に関する事項に含めていたのれんの償却額を、各報告セグメントに配分しています。また、当第1四半期より、従来は全社費用に含めていた一部費用を各報告セグメントに配分しています。なお、2020年3月期上半期のセグメント利益又は損失は、変更後の報告セグメントの利益又は損失の算定方法に基づき作成しています。



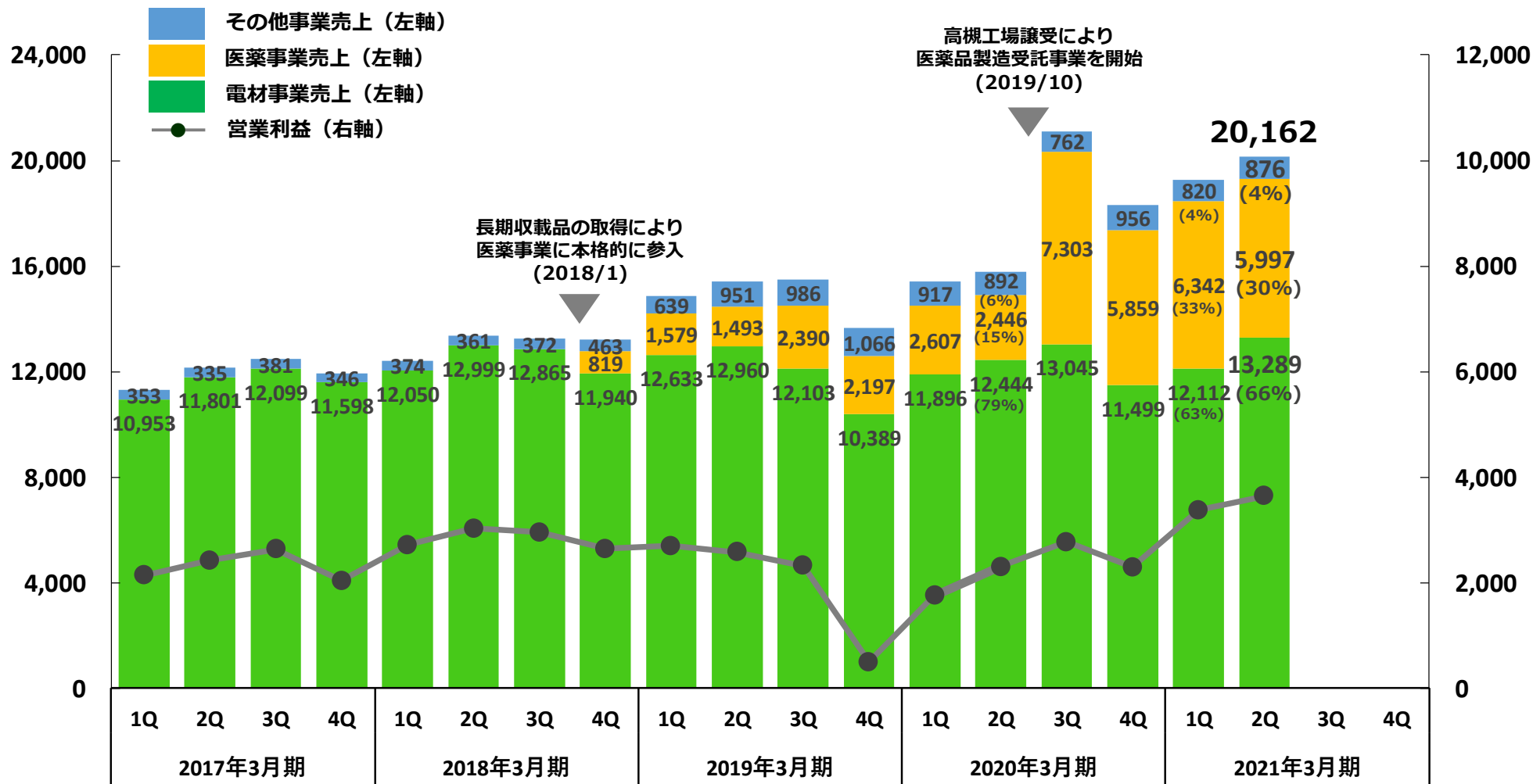
TAIYO HOLDINGS CO., LTD.

6

四半期別推移

四半期別推移：売上高/営業利益

単位：百万円



BSの概況

BS前期比較

単位：百万円

	20/3末	20/9末	増減
現金及び預金	29,191	53,361	24,170
受取手形及び売掛金	19,513	20,312	799
たな卸資産※1	11,408	12,388	980
その他	2,267	1,388	-879
流動資産合計	62,380	87,450	25,070
有形固定資産	44,761	43,953	-808
無形固定資産	30,769	35,693	4,924
その他	4,280	4,641	361
固定資産合計	79,811	84,288	4,477
資産合計	142,192	171,738	29,546

	20/3末	20/9末	増減
借入金※2	55,711	81,158	25,447
支払手形及び買掛金	7,231	7,800	569
その他	9,726	9,748	22
負債合計	72,668	98,708	26,040
株主資本	69,651	72,820	3,169
その他	-429	-93	336
非支配持分	301	303	2
純資産合計	69,523	73,030	3,507
負債純資産合計	142,192	171,738	29,546

自己資本比率	48.7%	42.3%	-6.4%
--------	-------	-------	-------

※1 たな卸資産：商品及び製品+仕掛品+原材料及び貯蔵品

※2 借入金：短期借入金+1年内返済予定の長期借入金+長期借入金

電子機器用部材事業

用語説明

用語	内容
PWB (Printed Wiring Board)	プリント配線板
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト（レジストインキ）
PKG (Package)	半導体パッケージ
DF (Dry Film)	ドライフィルム

電子機器用部材事業

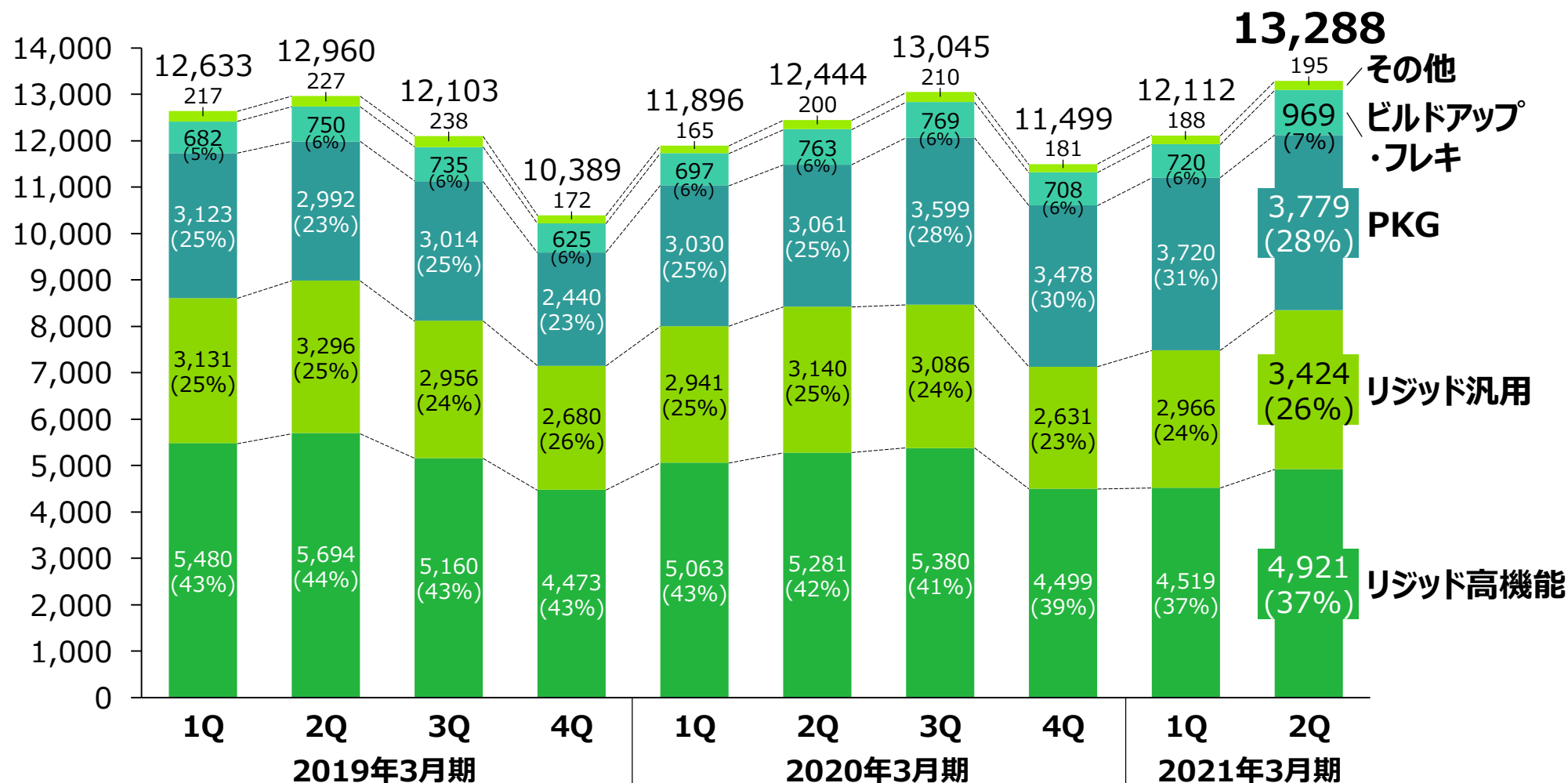
製品分野

分野	分類		性状	用途
PWB用 絶縁材料	リジッド	汎用品	液状	表層保護・絶縁用 SR材料
		高機能品	液状／DF	
	PKG		液状／DF	
	フレキ		液状／DF	
	ビルドアップ		液状／DF	層間絶縁・穴埋め用 ビルドアップ材料
その他 関連商材	その他		液状	マーキング・エッチング・めっき用材料 フラックス・溶剤等・導電性銀ペースト

電子機器用部材事業

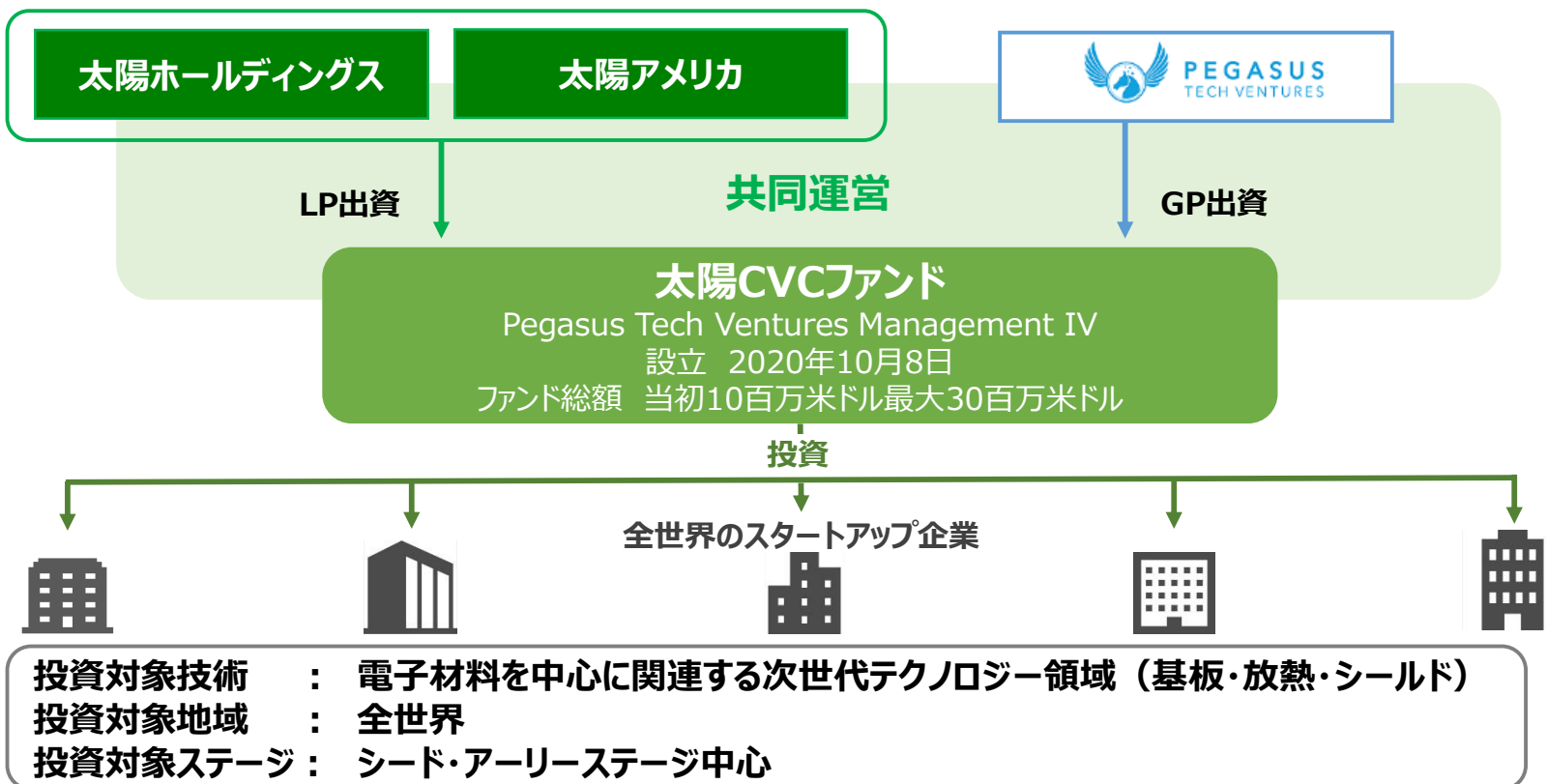
製品区分別売上高

単位：百万円



シリコンバレーにコーポレートベンチャーファンド(CVC)を設立

当社と将来的に事業シナジーが見込まれる有益な技術・事業をもつスタートアップ企業への投資を目的にシリコンバレーを拠点とするPegasus Tech Ventures※ をパートナーにCVCを設立



※Pegasus Tech Ventures 本社：米国カリフォルニア州、代表者アニス・ウツザマン

医療・医薬品事業

用語説明

用語	内容
長期収載品	新薬として発売された後に特許期間もしくは再審査期間が終了し、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の販売が可能となっている先発品
CDMO	医薬品製造及び医薬品製剤開発を受託する機関 (Contract Development Manufacturing Organization)
GMP	医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準 (Good Manufacturing Practice)

サイフューズとの細胞製品製造のパートナーシップ契約締結

国内の再生医療をけん引する京都・大阪の間、大阪府高槻市に位置する太陽ファルマテックにおいて、細胞製品の製造受託事業開始に向け、サイフューズとパートナーシップ契約を締結



京都

主な再生医療推進拠点

- 京都大学
- 京都府立医科大学など

高槻



太陽ファルマテック



大阪

主な再生医療推進拠点

- 大阪大学
- 未来医療国際拠点
- 2025年日本国際博覧会など

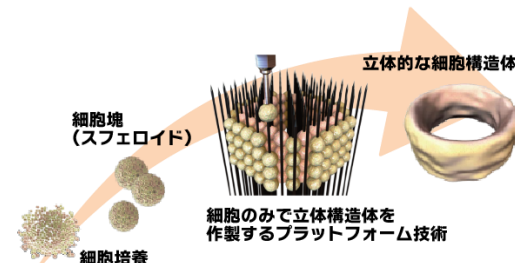
名称

株式会社サイフューズ

事業内容

- ✓ 再生医療等製品の研究・開発・製造・販売
- ✓ バイオ3Dプリンタの開発・販売

プラットフォーム技術



TAIYO HOLDINGS CO., LTD.

16

遺伝子治療研究所と製造に関する契約締結

遺伝子治療研究所と遺伝子治療用製品製造に関する契約を締結。
太陽ファルマテックにおいて、遺伝子治療研究所より技術提供を受け、
遺伝子治療用製品の製造受託事業開始に向け製造設備を構築。

遺伝子治療用製品について

遺伝子治療とは、“疾病の治療を目的として遺伝子又は遺伝子を導入した細胞を人の体内に投与すること”と定義されており*、現在、世界中で多様な遺伝子治療の研究が進んでいます。

国内においても保険適用された遺伝子治療用製品が臨床現場でも使用され始め、今後も、これまで治療法のなかった難病に対し、また既存治療薬が存在する疾患に対しても画期的な効果が期待される、革新的な遺伝子治療用製品の使用が本格化していくと考えられます。

*厚生労働省「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」

遺伝子治療研究所の概要

会社名

株式会社遺伝子治療研究所



事業内容

AAV（アデノ随伴ウイルス）を、ベクターとして利用した遺伝子治療用製品の開発及び製造



TAIYO HOLDINGS CO., LTD.